

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第6部門第2区分
【発行日】平成26年12月25日(2014.12.25)

【公表番号】特表2014-507684(P2014-507684A)
【公表日】平成26年3月27日(2014.3.27)
【年通号数】公開・登録公報2014-016
【出願番号】特願2013-552263(P2013-552263)
【国際特許分類】

G 0 2 B 6/00 (2006.01)

【F I】

G 0 2 B 6/00 3 3 6

【手続補正書】

【提出日】平成26年11月4日(2014.11.4)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ケーブル管理トレイ上でケーブルを案内するためのチャンネル・アセンブリであって、
入口端部および出口端部と、当該隔壁部間に上部が開いた複数のチャンネルを形成するよ
うに前記入口端部と前記出口端部の間で伸びる複数の隔壁部と、を有し、各チャンネルの開
いた上部を通して各チャンネル内にケーブルを配置することができるダクト部材と、
各チャンネルに関連づけて設けられた保持部材であって、各保持部材が、隣接の1対の隔壁
部間に形成された前記チャンネルの前記開いた上部を閉じるように前記隣接の1対の隔壁部
の前記開いた上部と係合可能である、保持部材と、
を含み、

前記保持部材が前記隔壁部に係合されたときに、下向きに前記チャンネル内へと伸びる各保
持部材上に、弾性変形可能な領域が形成されて、弾性変形可能な部材と前記チャンネルの底
部の間の前記チャンネル内に位置する複数のケーブルが圧縮され、それによって前記複数の
ケーブルが所定位置に確実に保持される、
チャンネル・アセンブリ。

【請求項2】

前記弾性変形可能な部材の高さは、弾性変形可能な材料の前記チャンネル内へと伸びる距
離を変化させることによって、相異なるケーブル束の高さ/太さが収容できように、調整
可能なものである、請求項1に記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項3】

前記弾性変形可能な部材は、互いに積層され、分離線を形成する狭い接続ラインに沿っ
て互いに接続された、複数の平坦なパネルによって形成され、
前記保持部材の高さを減少させるために、前記分離線によって底部のパネルが前記積層の
残部から容易に取り外し可能であり、それによってより多くのケーブルを前記チャンネルに
収容できる、請求項1または2に記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項4】

各平坦なパネルは縦方向の端縁に沿ってその隣接の平坦なパネルに接合され、1つのパ
ネルは前記端縁に沿って引き裂くことによって前記積層から容易に分離可能である、請求
項3に記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項5】

各パネルが、取り外し可能な形態でその隣接のパネルに再取り付け可能である、請求項 3 に記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項 6】

各保持部材は、チャンネルの上部を横切る所定位置に積極的にラッチされて、所定位置に確実に保持されるようになる、請求項 1 乃至 5 のいずれかに記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項 7】

各保持部材は、前記複数の隔壁部の上部付近に形成された複数の凹所に精密嵌合する複数の突出部を含むものである、請求項 6 に記載のチャンネル・アセンブリ。

【請求項 8】

複数のファイバ管理バック・プレートを含むファイバ管理システムであって、各バック・プレートは、そのバック・プレート上に形成されていて、そのバック・プレートに管理カセットを取外し可能な形態で係合する複数の同形の係合手段と、複数の管理カセットとを有し、

各管理カセットは、その管理カセット上に形成されていて、前記バック・プレート上に設けられた前記係合手段と取外し可能な形態で係合する相補的な係合手段を有し、

前記複数の管理カセットは、前記バック・プレートの隣接の係合手段の相互間の中心距離に実質的に等しい第 1 の厚さの少なくとも 1 つのカセットと、前記第 1 の厚さより大きい第 2 の厚さの少なくとも 1 つのカセットとを含み、

各前記バック・プレートの全ての各係合手段は前記第 1 の厚さの前記カセットによって占有されてもよく、

一方、前記第 2 の厚さのカセットは、前記バック・プレートが取り付けられる前記係合手段に隣接する前記バック・プレートの少なくとも 1 つの係合手段を排除し、それによって、前記第 2 の厚さの前記カセットが前記バック・プレートの少なくとも 1 つおきの係合手段にのみ取り付けられることが可能となる、

ファイバ管理システム。

【請求項 9】

前記第 2 の厚さは前記第 1 の厚さの 2 倍であり、前記第 2 の厚さの前記カセットの前記係合手段は、その 1 つの面（前面または背面）に近接して配置されて、前記バック・プレートに取り付けられたときに、前記バック・プレートの前記隣接の係合手段のみが一側面上において排除されるようになっている、請求項 8 に記載のファイバ管理システム。

【請求項 10】

追加的な複数の厚さのカセットを含む、請求項 8 または 9 に記載のファイバ管理システム。

【請求項 11】

各カセットは前記第 1 の厚さの整数倍の厚さを有するものである、請求項 10 に記載のファイバ管理システム。

【請求項 12】

奇数の整数倍の厚さの場合に、前記係合手段は前記カセットの前記厚さの中心に位置して、前記バック・プレートの利用される前記係合手段の前および後にある等しい数の係合手段が排除されるようになっているものである、請求項 11 に記載のファイバ管理システム。